

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-46313

(43)公開日 平成8年(1996)2月16日

(51)Int.CI.*	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
H 05 K 1/14		A		
H 01 L 21/60	3 1 1	S 7726-4E		
H 05 K 3/36		B		

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全4頁)

(21)出願番号 特願平6-178404

(22)出願日 平成6年(1994)7月29日

(71)出願人 000005223
富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72)発明者 山崎 崇樹
神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
富士通株式会社内

(72)発明者 池端 慶治
神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
富士通株式会社内

(72)発明者 岡田 徹
神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
富士通株式会社内

(74)代理人 弁理士 松本 昂

(54)【発明の名称】 パッケージの実装構造

(57)【要約】

【目的】 本発明はボールグリッドアレイの実装構造に
関し、接合部にクラックが発生しにくく製造作業性に優
れた実装構造の提供を目的とする。

【構成】 パッケージ2の下面に設けられた複数の半田
バンプ4をプリント配線板6上で溶融させることでパッ
ケージ2とプリント配線板6の半田付けを行うようにし
た実装構造において、パッケージ2の下面の直線上にな
い少なくとも3箇所にダミーバンプ10を設けて構成す
る。

第1 図 例 図

